

Helios

用于晶圆检测的检查与测量模块

晶圆上的缺陷发现得越晚，代价就越高。Helios 在裂纹与损伤成为问题之前将其找出：晶圆通过真空吸附固定在加热板上，按配方受控加热，并在结构光下逐步拍摄。智能物体识别让裂纹与损伤清晰可见，并对每个结果留下可追溯的记录。

检测流程

固定与加热: 晶圆通过真空吸附固定在加热板上，按配方以设定的升温与保温时间达到目标温度。

照明与拍摄: 穹顶光源将条纹图案投射到晶圆上；线性轴逐步移动晶圆，相机连续拍摄序列图像。

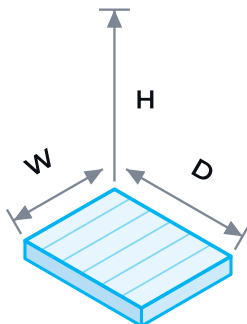
分析与记录: 分析程序在图像中识别裂纹与损伤，并为每片晶圆留下可追溯的检测记录。



技术数据

功能	温度条件下晶圆的检查与测量
晶圆承载	真空吸附固定于加热板
加热	配方控制，含设定的升温与保温时间
光学	带狭缝光阑的穹顶光源、相机、线性轴
分析	智能物体识别、实时图表监控、数据导出
控制	内置 IPC，含配方管理
接口	Ethernet、EtherCAT、SECS、API、FDC、数字 I/O
安全	安全监控门，整机 UPS 供电
环境	洁净室等级最高 ISO 5（含），全天候连续运行，冗余架构

占地尺寸



0.76 m

W 宽度

0.99 m

D 深度

1.32 m

H 高度

占地尺寸不含外伸部件。